

Fujitsu рекомендует Windows.

Техническое описание

Рабочая станция Fujitsu CELSIUS M770

Воплотите свои идеи в жизнь

Специалисты компании Fujitsu гордятся своим опытом в области разработки новых решений, которые позволяют оптимизировать CELSIUS M770 для решения современных сложных профессиональных и технических задач, что делает данную настольную рабочую станцию идеальной для работы приложений автоматизированного проектирования и конструирования, а также ресурсоемких мультимедийных и развлекательных приложений.

Производительность, на которую можно положиться
Высочайший уровень производительности благодаря компонентам профессионального класса

- Возможность выбора процессора: процессоры Intel® Core™ или мощные процессоры Intel® Xeon® семейства W
- Поддержка ОС Windows 10 Pro для рабочих станций
- Поддержка памяти DDR4 2666 до 256 ГБ
- Плата SSD Fujitsu PCIe (до двух плат по 2 ТБ)

Интеллектуальные функции безопасности
Инновации, ориентированные на человека, соответствуют требованиям безопасности

- Дополнительный замок безопасности (боковая крышка и доступ с передней панели)
- Датчик обнаружения открытия корпуса, встроенный в источник питания
- USB-клавиатура со встроенной технологией PalmSecure™: удобный вход в систему посредством сканирования рисунка вен ладони

Удобство использования и интеллектуальный доступ

Совершенство разработки

- Конструкция без внешних кабелей, выделенные зеленым цветом точки техобслуживания
- Cold-plug: технология безвинтового крепления накопителей без вскрытия корпуса рабочей станции
- Для монтажа в стойку (4U)

Разработано в Германии

Разработано в Германии с использованием японских инноваций — качество, которому можно доверять



RADEON PRO WX

Компоненты

	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Процессор	Процессор Intel® Xeon® W-2102 (4 ядра, 2.90 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2104 (4 ядра, 3.20 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2123 (4 ядра, 3.60 ГГц, до 3,9 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2125 (4 ядра, 4.00 ГГц, до 4,5 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2133 (6 ядер, 3.60 ГГц, до 3,9 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2135 (6 ядер, 3.70 ГГц, до 4,5 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2145 (8 ядер, 3.70 ГГц, до 4,5 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2155 (10 ядер, 3.30 ГГц, до 4,5 ГГц) Процессор Intel® Xeon® W-2175 (14 ядер, 2.50 ГГц, до 4,4 ГГц)	
	Технология Intel® vPro™	
Операционные системы		
Предустановленная операционная система	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Pro
Совместимость с операционными системами	Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) Linux	
Примечания по операционным системам	Сертифицировано для Red Hat® Enterprise Linux Сертифицировано для SUSE Enterprise Desktop Сертифицировано для SUSE Enterprise Server	
	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Модули памяти	8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,666 МГц 16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,666 МГц 32 ГБ (1 модуль/модули 32 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,666 МГц	8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, небуферизованная, non-ECC, 2,666 МГц, UDIMM 16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, небуферизованная, non-ECC, 2,666 МГц, UDIMM

	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Графическая плата	<p>Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P5000, 16 ГБ, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort</p> <p>High-end 3D: NVIDIA® Quadro® RTX 4000, 8 ГБ, PCIe x16, 3 x DisplayPort, 1 x Virtual Link</p> <p>High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>High-end 3D: AMD Radeon™ Pro WX 7100 , 8 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2200, 5 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>Midrange 3D: AMD Radeon™ Pro WX 5100, 8 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P620, 2 ГБ, PCIe x16, 4 x miniDP</p> <p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 ГБ, PCIe x16, 3 x miniDP</p> <p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 ГБ, PCIe x16, 4 x miniDP</p> <p>Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 3100, 4 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP</p> <p>Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 2100, 2 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP</p> <p>Remote Graphics: Четырехпортовая плата CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 4 x miniDP, PColP</p> <p>Remote Graphics: Двухпортовая плата CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 2 x miniDP, PColP</p> <p>Others: Соединительный кабель MiniDP-DP</p> <p>Others: Кабель адаптера DP и DVI-D (с одиночной связью)</p>	<p>Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® P5000, 16 ГБ, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort</p> <p>High-end 3D: NVIDIA® Quadro® RTX 4000, 8 ГБ, PCIe x16, 3 x DisplayPort, 1 x Virtual Link</p> <p>High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>High-end 3D: AMD Radeon™ Pro WX 7100 , 8 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2200, 5 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>Midrange 3D: AMD Radeon™ Pro WX 5100, 8 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 4 x DisplayPort</p> <p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P620, 2 ГБ, PCIe x16, 4 x miniDP</p> <p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 ГБ, PCIe x16, 3 x miniDP</p> <p>Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 ГБ, PCIe x16, 4 x miniDP</p> <p>Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 3100, 4 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP</p> <p>Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 2100, 2 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP</p> <p>Others: Соединительный кабель MiniDP-DP</p> <p>Others: Кабель адаптера DP и DVI-D (с одиночной связью)</p>

	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Жесткий диск	<p>HDD SAS, 10 000 об./мин., 1200 ГБ, 2,5-дюймовый</p> <p>HDD SAS, 10 000 об./мин., 1800 ГБ, 2,5-дюймовый</p> <p>HDD SAS, 10 000 об./мин., 2400 ГБ, 2,5-дюймовый</p> <p>HDD SAS, 10 000 об./мин., 600 ГБ, 2,5-дюймовый</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 2048 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 2048 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 2048 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ,</p>	<p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 2048 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 2048 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 2048 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe</p> <p>SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe</p> <p>Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ,</p> <p>Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ,</p> <p>3,5-дюймовый</p> <p>Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ,</p>

Примечания по жесткому диску

1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт.

Поддержка круглосуточной работы (требуются жесткие диски для важных бизнес-приложений, жесткие диски SAS или твердотельные диски с высокой стабильностью)

До 20 ГБ пространства на жестком диске зарезервировано для выполнения восстановления системы

SED (привод со встроенной поддержкой шифрования)

SSD (твердотельный накопитель)

	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Оптический привод	Многофункциональное устройство чтения карт памяти "24 в 1"; USB 2.0, 3.5"; USB 2.0 Привод DVD-ROM Супермультиформатный DVD-привод, SATA Мультиформатный сверхтонкий дисковод DVD (лоток), SATA BD Triple Writer SATA тонкий привод (лоток), SATA	Многофункциональное устройство чтения карт памяти "24 в 1"; USB 2.0, 3.5"; USB 2.0 Привод DVD-ROM Супермультиформатный DVD-привод, SATA Мультиформатный сверхтонкий дисковод DVD (лоток), SATA BD Triple Writer SATA тонкий привод (лоток), SATA
SCSI / SAS контроллер	LSI RAID Ctrl SAS 1GB (D3216) RAID 5/6 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int. LSI RAID Ctrl SAS (D3327) RAID 0/1 Ctrl. 12 Gbit/s 8 ports int. Intel VROC HW key Standard M.2	
	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Интерфейсы плат расширения / компонентов	Интерфейс eSATA Две последовательные платы PCIe x1 Два порта PCIe x8 10 Гбит/с Ethernet Адаптер Intel 2x1Gb Ethernet I350-T2 WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH и Bluetooth 4.1 (отдельные регионы, до Bluetooth 4.2 в зависимости от версии ОС) WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH (отдельные регионы) PLAN EP X550-T2 2x10GBASE-T Gigabit Ethernet PCIe x1	Интерфейс eSATA Две последовательные платы PCIe x1 Два порта PCIe x8 10 Гбит/с Ethernet WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH и Bluetooth 4.1 (отдельные регионы, до Bluetooth 4.2 в зависимости от версии ОС) WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH (отдельные регионы) Gigabit Ethernet PCIe x1
Базовый модуль	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Материнская плата		
Тип материнской платы	D3498-A	D3498-U
Форм-фактор	расширенный ATX	расширенный ATX
Набор микросхем	Intel® C422	Intel® X299
Процессорный разъем	Разъем R4	Разъем R4
Максимальное количество процессоров	1	1
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.)	256 ГБ	128 ГБ
Разъемы памяти	8 DIMM (DDR4) с поддержкой ECC	8 DIMM (DDR4)
Частота памяти	2,666 МГц	2,666 МГц
Примечания по памяти	4 канала памяти с поддержкой до 2 модулей DIMM на канал. В случае четырех каналов необходимо заказывать не менее 4 модулей памяти и емкость для каждого канала должна быть одинаковой. Частота DDR4 2666 МГц может понижаться до 2400 или 2133 в зависимости от процессора.	4 канала памяти с поддержкой до 2 модулей DIMM на канал. В случае четырех каналов необходимо заказывать не менее 4 модулей памяти и емкость для каждого канала должна быть одинаковой. Частота DDR4 2666 МГц или 2400 МГц (в зависимости от модели ЦП) может понижаться в зависимости от конфигурации памяти.
LAN	10/100/1,000 Мбит/с Intel® I219LM	10/100/1,000 Мбит/с Intel® I219LM
Версия BIOS	AMI Aptio V	AMI Aptio V
Функции BIOS	BIOS Flash EPROM: обновление с помощью программного обеспечения Технология восстановления BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)	BIOS Flash EPROM: обновление с помощью программного обеспечения Технология восстановления BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Тип аудиоплаты	Встроенный	Встроенный
Аудиокодек	Realtek ALC671	Realtek ALC671
Функции аудиоплаты	Звук высокой четкости	Звук высокой четкости
Встроенный контроллер ввода-вывода		
Общее кол-во портов Serial ATA	8	
из них SATA III	8	
Функции контроллера	Serial ATA III (6 Гбит/с) NCQ AHCI RAID 0/1/5/10	

Интерфейсы

Аудиоразъемы: вход (на задней панели)	1
Аудиоразъемы: выход (на задней панели)	1
Аудиоразъемы: вход	1
Аудиоразъемы: выход	1
Внутренние динамики	1
Общее кол-во портов USB 2.0	2 дополнительных — с передней панели
USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. кол-во	6
USB 3.1, поколение 2, общ. кол-во	2 дополнительных — с передней панели
Разъем USB на передней панели	2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.1 (1-го поколения); дополнительно: 2 порта USB 3.1 Type-C (2-го поколения) вместо 2 портов USB 2.0
Разъем USB на задней панели	6
Внутренний разъем USB	3, из них 1 типа А
Ethernet (RJ-45)	1
eSATA	1 (дополнительно)
Примечания по интерфейсным модулям	Возможность зарядки устройств через порт USB в любое время

Отсеки для

Общее кол-во отсеков для дисков	7
2,5-дюймовые внутренние отсеки	4
3,5-дюймовые внутренние отсеки	4
3,5-дюймовые внешние отсеки	1
5,25-дюймовые внешние отсеки	1
Примечания по отсекам для дисков	Всего 4 лотка для дисков 3,5 дюйма / 2,5-дюйма с доступом с передней панели (технология cold-plug)
M.2-2280	1 x на материнской плате (для PCIe и модулей твердотельного накопителя)

Разъемы

PCI-Express 3.0 x1	2 x (340 мм / 13,39 дюйм) Полной высоты	2 x (340 мм / 13,39 дюйм) Полной высоты
PCI-Express 3.0 x4	2 x (340 мм / 13,39 дюйм) Полной высоты	1 x (200 мм / 7,87 дюйм) Полной высоты
PCI-Express 3.0 x8	1 x (200 мм) Полной высоты	1 x (340 мм) Полной высоты
PCI-Express 3.0 x16	2 x (340 мм / 13,39 дюйм) Полной высоты	1 x (340 мм / 13,39 дюйм) Полной высоты
Оптимальная конфигурация разъемов	Переход с 1 разъема PCI-Express 3.0x8 на 1 разъем PCI-Express 3.0x16 и 2 дополнительных разъема PCI-Express 3.0x4 (340 мм/13,39 дюйма) с процессором Intel® Core™ i9	
Базовый модуль	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)

Электрические характеристики

Примечания по энергопотреблению	225 Вт в зависимости от конфигурации	
Номинальный диапазон напряжений	100–240 В	
Номинальный диапазон частот	50–60 Гц	
Рабочий диапазон напряжений	90–264 В	
Рабочий диапазон частоты линий	47–63 Гц	
Макс. мощность одного блока питания	450 Вт, КПД до 90%	
Коррекция коэффициента мощности/фактической мощности	активный	
Выходное напряжение блока питания	2 шины питания графической подсистемы (на материнской плате)	
Базовый модуль	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)

Уровень шума в стандартной конфигурации (жесткий диск, оптический привод)

Сведения об уровне шума вентиляторов процессоров	Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора: 140 Вт	Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора: 140 Вт
Примечания / описание стандартного уровня шума	Взвешенный уровень акустической мощности L _{wad} (в Б) на рабочее место, соответствующий эквивалентному уровню звукового давления L _{pAm} в дБ (А)	Взвешенный уровень акустической мощности L _{wad} (в Б) на рабочее место, соответствующий эквивалентному уровню звукового давления L _{pAm} в дБ (А)
Стандартный уровень шума	В соответствии с ISO 7779:2010, ECMA-74	В соответствии с ISO 7779:2010, ECMA-74
Уровень шума. Стандартный режим работы: 50% нагрузка ЦП	3,6 Б / 20 дБ (А) – для стороннего наблюдателя	3,6 Б / 20 дБ (А) – для стороннего наблюдателя
Уровень шума. Стандартный режим работы: 90% нагрузка ЦП	3,7 Б / 20 дБ (А) — для стороннего наблюдателя	3,7 Б / 20 дБ (А) — для стороннего наблюдателя
Уровень шума. Стандартный режим работы: нагрузка оптического привода	4,5 Б / 28 дБ (А) — для стороннего наблюдателя	4,5 Б / 28 дБ (А) — для стороннего наблюдателя
Уровень шума. Стандартный режим работы: офисные приложения 2.0	3,7 Б / 21 дБ (А) — для стороннего наблюдателя	3,7 Б / 21 дБ (А) — для стороннего наблюдателя
Уровень шума. Стандартный режим работы: режим ожидания	3,5 Б / 19 дБ (А) — для стороннего наблюдателя	3,5 Б / 19 дБ (А) — для стороннего наблюдателя
Уровень шума. Стандартный режим работы при работе жесткого диска	3,5 Б / 19 дБ (А) — для стороннего наблюдателя	3,5 Б / 19 дБ (А) — для стороннего наблюдателя

Габариты / вес / экологичность

Габариты (Ш x Г x В)	176 x 500 x 433 мм 6,9 x 19,7 x 17,1 дюйм
Рабочее положение	Вертикально/горизонтально
Вес	примерно 18 кг
Вес (фунты)	примерно 39,67 lbs
Примечания по весу	Реальный вес может различаться в зависимости от конфигурации
Рабочая температура окружающей среды	10 - 35 °C
Рабочая относительная влажность	5 - 85 % (относительная влажность)

Соответствие стандартам

Продукт	CELSIUS M770
Модель	CM17
Германия (Германия)	GS в зависимости от конфигурации
Европа	CE
США/Канада	FCC Class B cCSAus
Весь мир	RoHS (ЕС и Китай) Операционные системы Microsoft (HCT / HCL начального уровня / WHQL) WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования) Соответствие стандарту ENERGY STAR® 7.0
Китай	CCC (в зависимости от конфигурации) TPM 2.0 для Китая (дополнительно)
Примечания по вопросу совместимости	После названия продукта может указываться суффикс
Ссылка по вопросам совместимости	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Дополнительное ПО

Дополнительное ПО (предустановленное)	Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации) McAfee® LiveSafe™ (обеспечивает удостоенную наград защиту от вирусов для вашего ПК и другие возможности; 30-дневная пробная версия) Microsoft Office (пробная версия на 1 месяц для новых клиентов Microsoft® Office 365. Купить Microsoft Office.)
Дополнительное ПО (опциональное)	DVD-диск для восстановления для Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (ПО для воспроизведения DVD/BD согласно спецификации Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (ПО для воспроизведения DVD) Nero Essentials XL

Базовый модуль	CELSIUS M770 (S26361-K1507-V115)	CELSIUS M770x (S26361-K1507-V215)
Безопасность		
Физическая безопасность	Поддержка замка Kensington Ушко для висячего замка Датчик открытия корпуса Встроенный замок для стойки (дополнительно)	Поддержка замка Kensington Ушко для висячего замка Датчик открытия корпуса Встроенный замок для стойки (дополнительно)
Безопасность системы и BIOS	Встроенная безопасность (дополнительный модуль TPM 2.0) Защита загрузочного сектора от вирусов Параметр защиты от записи в модуль памяти Flash EPROM Управление всеми USB-интерфейсами Внешние USB-порты могут быть отключены по отдельности Управление внешними интерфейсами	Встроенная безопасность (дополнительный модуль TPM 2.0) Защита загрузочного сектора от вирусов Параметр защиты от записи в модуль памяти Flash EPROM Управление всеми USB-интерфейсами Внешние USB-порты могут быть отключены по отдельности Управление внешними интерфейсами
Безопасность пользователя	Пароль пользователя и супервизора для BIOS Защита жесткого диска паролем Защита доступа с помощью внешнего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Защита доступа с помощью внутреннего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)	Пароль пользователя и супервизора для BIOS Защита жесткого диска паролем Защита доступа с помощью внешнего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Защита доступа с помощью внутреннего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)
Доступные непосредственно на рабочем месте («встроенные») инструменты	Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера Fujitsu Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера заказчика (дополнительно) Простая защита ПК (дополнительно)	Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера Fujitsu Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера заказчика (дополнительно) Простая защита ПК (дополнительно)
Управление		
Технология управления	Средство управления драйверами DeskUpdate iAMT 11.6 (в зависимости от процессора) Загрузочный код PXE 2.1 Пробуждение из S5 (режима отключения) Датчик открытия корпуса (дополнительно) WoL (пробуждение по сети)	
ПО управления	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management	
Компоненты DeskView	Управление инвентаризацией Управление BIOS Управление драйверами Управление безопасностью Управление предупреждениями	
Поддерживаемые стандарты	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)	
Ссылка на ресурсы по вопросам управления	www.fujitsu.com/ru/services/	
Прочее		
Доступность запасных частей	Для монтажа в стойку (4U) 5 лет	Для монтажа в стойку (4U) 5 лет
Сведения об упаковке		
Примечания по упаковке	Пользовательская документация отпечатана на бумаге, обработанной бесхлорным процессом	Пользовательская документация отпечатана на бумаге, обработанной бесхлорным процессом
Гарантия		
Гарантийный срок	3 года (в зависимости от страны)	
Тип гарантии	Услуга бесплатной доставки отремонтированного оборудования/выезда ремонтной бригады на место (для стран региона EMEA, для всех других стран условия обслуживания зависят от местных нормативных требований)	

Гарантия

Положения и условия гарантии <http://www.fujitsu.com/warranty>

Услуги поддержки продуктов — идеальное дополнение

Рекомендуемое обслуживание Техническая поддержка 5 дней в неделю, в рабочее время, выезд к заказчику на следующий рабочий день

Доступность запасных частей 5 лет после окончания срока службы

Ссылка на веб-сайт обслуживания <http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/>

Рекомендуемые аксессуары**Монитор P27-8 TS Pro**

Монитор Fujitsu P27-8 TS Pro отлично подойдет специалистам с повышенными требованиями к разрешению, цветопередаче и производительности, использующим ресурсоемкие приложения. Монитор обеспечивает превосходную производительность отображения графики благодаря передовой технологии производства панелей и поддержки 3,7 млн пикселей. Кроме того, он обладает рядом уникальных и инновационных особенностей, таких как наш запатентованный датчик присутствия и интерфейс USB, доступный даже в режиме ожидания.

Order code:
S26361-K1594-V160

Монитор B34-9 UE

Монитор Fujitsu B34-9 UE — сверхширокоэкранный изогнутый монитор с разрешением 3440 x 1440 и тонкой рамкой корпуса. Монитор имеет кривизну экрана 1900R и обеспечивает широкий угол обзора, стабильное качество изображения, поддержку программного пакета DisplayView™ и широкий спектр возможностей подключения — это отличное решение для предприятий среднего и крупного бизнеса.

Order code:
S26361-K1642-V140



Order code:
S26381-K459-L100

Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to the FUJITSU Workstation CELSIUS M770, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/ru/products

Software

www.fujitsu.com/ru/products/software

Дополнительная информация

Learn more about the FUJITSU Workstation CELSIUS M770, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. www.fujitsu.com/ru

Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш новый всемирный проект по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Используя наши ноу-хау мирового масштаба, мы стремимся внести свой вклад в экологически безопасной окружающей среды с помощью ИТ-технологий. Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/environment



Авторские права

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru

2020-01-22 EM-RU

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use